

团 体 标 准

T/CWAN 0030—2021

软钎焊膏质量评价规范

Specification for quality evaluation of soft soldering paste

2021-12-29 发布

2022-02-01 实施

中国焊接协会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 质量评价要求	1
5 检验规则	7
6 包装、标志及质量证明	9

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国焊接协会提出并归口。

本文件起草单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司、哈尔滨焊接研究院有限公司、哈尔滨工业大学、郑州机械研究所有限公司、深圳市汉尔信电子科技有限公司、绍兴市天龙锡材有限公司、深圳市亿钺达工业有限公司。

本文件主要起草人：李维俊、徐锴、孙晓梅、何鹏、吕晓春、钟素娟、马鑫、戴登峰、徐金华、宋北。

软钎焊膏质量评价规范

1 范围

本文件规定了软钎焊膏(以下简称焊膏)的术语和定义、质量评价要求、检验规则、包装、标志及质量证明等。

本文件中Ⅰ级焊膏通常用在军工、航天电子器件高可靠性互连封装焊点上,Ⅱ、Ⅲ级焊膏通常用在一般常规的电气电子产品互连封装焊点上。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 3131 锡铅钎料
- GB/T 15829 软钎剂 分类与性能要求
- GB/T 20422 无铅钎料
- GB/T 33148 钎焊术语
- T/CWAN 0031—2021 软钎焊膏试验方法
- T/CWAN 0032 软钎焊膏 分类和性能要求

3 术语和定义

GB/T 33148 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

干燥度 **drying**

焊膏经回流焊接后,其表面残留物在室温冷却后发生粘黏的程度。

3.2

黏附性 **tackiness**

焊膏对元器件黏附力的大小及随焊膏印刷后放置时间增加其黏附力所发生的变化。

3.3

塌陷 **slump**

焊膏的一种缺陷,在进行焊膏涂敷试验时,印刷在承印物上的焊膏图形发生形状变化的现象。

3.4

稀释剂 **thinner**

含有或不含有活性剂的液态溶剂或膏状物,将其添加到焊膏中以调节焊膏的黏度和固态含量。

4 质量评价要求

4.1 一般规则

按照 T/CWAN 0031—2021 中规定的试验方法进行评价时,不同级别的焊膏应符合 4.3~4.5 的